

多芯片贴合设备



☆加热台温度: 25-550℃

☆贴装压力: 15-150g

☆XY 方向精度: $\pm 0.002\text{mm}$

☆自动更换吸头 (最多 12 头)

☆蓝膜上料 (Sub 和芯片都可)

☆可填充工艺气体